

發佈單位：円星科技股份有限公司

發佈日期：2026/8/12

円星科技 (M31)2026 年第二季線上法人說明會 Q&A 完整實錄

主講人：總經理 張原熏

Q1：請總經理說明 2027 年的營運展望（包含營收成長、毛利率、費用規劃以及整體的獲利能力發展方向）

答：2027 年的前提仍是先完成 2026 年下半年的營收目標。展望明年，權利金將是公司最重要的成長動能。不論是先進製程或成熟製程的新權利金收入，都將來自不同 Foundry（晶圓廠）與 Fabless（非晶圓廠）客戶，成長來源相對多元。

在 RD 人數及研發費用方面，公司將持續控管。隨著權利金占比提高，公司可更有效率地規劃客戶需求與新開案，若費用控制與權利金成長都能如預期進行，明年營收與獲利能力都有機會進一步提升。

此外，先進製程 IP、高階 Consumer、Automotive、AI/HPC 相關應用以及高階 SerDes，將是 2027 年的重要產品方向。總結來說，希望權利金成長，能夠讓過去幾年的投入開始帶來更好的回收成果。

Q2：關於第二季表現未達預期的主因與未來能見度？公司目前對於營收成長趨勢是否可以持續？對未來需求能見度有何看法以及中長期的發展前景？下半年營運最大的挑戰是什麼？

答：上半年最大的瓶頸在於新開案推進速度不如預期。目前公司洽談中的案件數量很多，但從討論到正式簽約的時程明顯拉長，因此造成部分案件延後認列。我們觀察到北美、歐洲、日本及韓國客戶的進度相對緩慢，但認為這些需求並未消失，而是時程遞延，因此有機會在下半年逐步補回。中長期來看，公司仍持續推動權利金占比提升，希望由目前十幾個百分點逐步提高至接近 20%，並在明年挑戰超過 20%。當權利金模式逐漸成熟後，公司未來將不需要依賴持續擴編 RD 來換取營收，獲利結構也可望顯著改善。

Q3：上半年營收達成率較不理想，目前是否仍維持原先的年度成長指引？有設定單月營收的低標嗎？另外，過去一年展望與實際成果的落差，會如何總結並優化預測流程，以避免外界期待與實際營收的落差？

答：公司仍維持原先設定的年度成長目標不變。

若以上半年完成約 40% 的進度來看，下半年必須完成剩餘約 60% 的營收目標，這是公司目前最重要的經營任務。

發佈單位：円星科技股份有限公司

發佈日期：2026/8/12

對於過去展望與實際成果之間的落差，確實需要檢討與改善。未來將持續強化與客戶間的溝通及需求確認，加快客戶決策與案件收斂速度。

同時，在合約簽訂或工作說明書產出後到正式簽約的流程也會持續優化，希望縮短中間作業時間，降低預測與實際結果之間的落差。

Q4：有沒有什麼授權金的專案進程可以分享？

答：經過過去幾年的投入與布局，公司預期下半年將正式切入台灣主要晶圓代工廠最先進製程平台，目前已取得相關合作資格，預計第三季開始陸續簽訂新的合作案。

除了既有客戶之外，公司近期也持續與主要晶圓代工廠深化合作，希望能在更多客戶導入最先進製程時參與相關專案。

管理層認為，不論是 A14 或 2 奈米，都有機會於今年下半年看到新案展開。此外，3 奈米至 8 奈米區間的 IP 產品布局也逐漸完整，從今年下半年到明年上半年仍會是重要的授權金來源。

Q5：請公司分享目前 7 奈米以下的先進製程案件發展情況。以及 2026 上半年與下半年的開案數佔比是否會有明顯變化？

答：7 奈米以下目前已是公司最重要的發展方向。目前超過 80% 的研發專案皆聚焦於先進製程領域，我們也期待未來先進製程相關營收占比能夠持續提高。

不過進入先進製程之後，開案數不一定會增加。由於客戶投入成本大幅提高，因此開案頻率通常較成熟製程低。公司的重點不在於案件數量增加，而是在於提升每個案件的價值，希望每筆專案金額都能顯著高於過去。

Q6：對先進製程後續佈局的計劃是什麼？以及因為先進製程的開發成本比較高，有沒有其他的因應對策？

答：公司整體研發資源仍以先進製程為重心。不過，公司不會為了擴大產品線而開發大量缺乏市場需求的 IP，而是優先投入具備商業化機會與客戶需求的產品。

面對開發成本提高，我們將更加重視 IP 的商業價值與市場需求，「能否順利銷售」將和技術能力同等重要。

此外，公司也持續加強產品品質與可靠度，因為先進製程產品一旦出現問題，其代價遠高於過去，因此品質管理與驗證能力將是未來的重要工作。

發佈單位：円星科技股份有限公司

發佈日期：2026/8/12

Q7：2 奈米和 3 奈米權利金今年的收取情況與貢獻度為何？先前提到 2 奈米的案子最快將在今年底貢獻營運，目前有沒有新的 Tape-out（設計定案）完成呢？

答：今年上半年公司的先進製程權利金已有明顯提升，主要來自 3 奈米案件開始進入貢獻階段。至於 2 奈米部分，目前已知客戶完成 Tape-out，後續將觀察實際量產動能。若量產時程順利，最快有機會在今年第四季至明年第一季開始看到 2 奈米權利金收入貢獻。

Q8：目前中國大陸車載/自駕系統的進度如何？

答：公司在中國車用市場已有一定布局，包括影音傳輸與自駕系統等領域。目前已有多家採用 M31 IP 的客戶，在 N6、N5 及 4 奈米平台上的首顆晶片開發進展順利，相關需求仍持續增加。此外，許多客戶在第一代產品完成後，也開始規劃功能擴充及下一代產品，因此可望持續帶來新的開案需求。管理層對中國車用市場仍維持正面看法，未來也希望進一步擴大客戶基礎。

Q9. 台灣龍頭晶圓代工廠（台積電）的先進製程營收佔比已經達到近八成，但為什麼 M31 的權利金卻沒有隨之大幅成長？

答：首先需要澄清的是，市場提到的「八成」並不是指 M31 在台積電先進製程平台上的市占率達到八成。公司與台積電的合作確實持續從 12 奈米、6 奈米逐步推進至 4 奈米等先進製程節點，但距離台積電整體客戶群實際採用比例仍有相當大的差距。

未來公司希望透過更多客戶採用 M31 IP，進一步累積權利金收入。現階段最重要的工作，是確保每一位採用 M31 IP 的客戶，不論是透過 Foundry 或 Design House 導入，都能夠為公司帶來持續性的權利金貢獻。

Q10. 請總經理分享對安森美（Onsemi）收購 Synaptics 相關業務的看法，以及對 M31 的影響？

答：Onsemi 與 Synaptics 目前都是 M31 的客戶，其中 Synaptics 更是 M31 早期在北美市場的重要客戶之一。就目前來看，雙方的合作關係並未受到影響，既有合作仍持續進行中。

未來若收購完成後產生更多 IP 導入、開發或合作需求，公司也希望能夠進一步參與相關機會。

Q11. 投資人非常關心，想請總經理說明和信驊科技日後的合作計劃。

答：信驊一直以來都是 M31 非常重要的合作夥伴。雙方自 2017 年開始合作，從 BMC 晶片到 Cupola 3D Camera 等產品，都有 M31 IP 的導入與合作。多年來不論管理團隊或研發團隊都建立

發佈單位：円星科技股份有限公司

發佈日期：2026/8/12

了良好的合作默契，因此這次能夠邀請信驊參與私募，公司也認為非常榮幸。

未來雙方將持續聚焦於 Server 相關產品及晶片合作，M31 也將依照信驊的需求，提供更多客製化 IP 產品來支援其發展。同時，透過 Server 相關 IP 的合作，公司也有機會接觸到過去較難切入的新客戶，並透過信驊的產業資源與客戶關係，進一步與美系大型客戶展開交流與合作。

Q12. 第一季曾提到公司針對 Edge AI 未來應用已進行完整 IP 佈局，是否計畫參與 Data Center 基礎建設？例如與半導體廠商合作光通訊，或與韓系記憶體大廠在先進製程方面的合作？

答：除了 Edge AI 之外，公司目前也持續布局 Data Center 與光通訊市場。今年上半年的一項重要進展，是聚焦於 PCIe Gen5、Gen6、Gen7 等高階 SerDes 技術，未來也希望進一步跨足 112G SerDes，以切入光通訊及 CPO 等相關應用。

在客戶布局方面，目前韓系記憶體大廠已經採用 M31 的產品，後續仍有進一步擴大合作的空間。

至於美系先進製程客戶，公司也持續投入資源，不論成熟製程或先進製程都希望增加覆蓋率，並期待下半年有機會與市場分享新的進展。

Q13. 請總經理分享一下美國客戶高階訂單的認列進度，或北美 CSP（雲端服務供應商）開案的最新進度與展望？

答：美國客戶在極先進製程開案時，決策流程與討論時間相對較長，因此案件推進速度也較一般案件慢。以目前掌握的情況來看，公司期待在第三季完成最新一代合作案的簽署。

至於 CSP 方面，公司持續與相關客戶接觸，同時透過 Design Service 公司的合作資源，建立更多與 CSP 客戶的連結。由於這些合作夥伴與大型雲端客戶關係密切，因此有助於公司進一步切入相關專案。若後續有進一步成果，公司也將再向市場更新。

Q14. 想請問 M31 在特用晶片（ASIC）的接案狀況如何？

答：公司不會特別區分 ASIC Design Service 公司或 Fabless 客戶。對 M31 而言，只要客戶有 IP 需求，不論是設計服務公司或自行開發晶片的 Fabless 業者，皆屬於潛在合作對象。

目前公司與台灣主要 ASIC House 均已建立成熟合作關係，而未來的重要發展方向之一，就是持續將 IP 產品拓展至美系大型晶片設計服務公司。

去年公司已與一家北美客戶展開第一個合作案，目前也正在探討新的 3 奈米專案合作機會。

發佈單位：円星科技股份有限公司

發佈日期：2026/8/12

Q15. 眾多推論晶片（Inference Chip）的 SRAM 設計，有沒有可能採用公司的 IP？還是通常會選擇自行設計？

答：公司目前擁有相當完整的 SRAM 開發團隊，主要仍以與 Foundry（晶圓廠）共同合作的產品開發模式為主。

隨著 AI 推論晶片及先進製程需求持續增加，公司近期確實接獲更多高階 SRAM 的客製化需求。不論是 2 奈米、3 奈米甚至更先進的製程節點，公司都希望持續投入相關產品開發並爭取更多導入機會。若未來有進一步成果，也會適時向市場分享。